

证券代码： 003031

证券简称：中瓷电子

河北中瓷电子科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

2025-003 号

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025 年 9 月 2 日 (周二) 下午 15:00~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长 卜爱民 2、常务副总经理（代总经理） 梁向阳 3、财务总监、副总经理、董事会秘书 董惠 4、中信证券投行委工业与先进制造行业组副总裁 肖尧 5、中航证券有限公司证券承销与保荐分公司业务董事 闫亚格
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、如何解读 2025 年上半年已完成的经营业绩情况和对下半年的经营情况展望？ 您好，2025 半年报，公司高端产品放量，叠加降本增效效果明显，公司盈利能力显著提升。公司营收达 13.98 亿元，同比增长 14.37%；归母净利润 2.78 亿元，同比增长 30.92%，业绩快速提升。其中电子陶瓷材料及元件表现依然亮眼。随着 AI 算力需求的持续增长，将推动数字经济蓬勃发展，带动半导体、通信、消费电子、新能源汽车等行业持续增长，以光模块为代表的电子元器件和半导体设备等行业市场规模持续上升。第三代半导体氮

	化镓通信基站射频芯片与器件领域，紧密围绕战略目标，坚持“市场牵引、科技驱动”，在保持现有优势的基础上，进一步提升市场占有率，保障公司持续、健康、稳定发展。第三代半导体碳化硅功率模块及其应用领域，2025 年上半年，碳化硅芯片晶圆工艺线经过升级改造由 6 英寸升级为 8 英寸，目前已通线，处于产品升级及客户导入阶段，今后将有效提升国联万众碳化硅功率产品的市场竞争力。 2025 年下半年公司也将始终着力于主营业务发展和核心技术创新，不断加强公司的研发能力、提高产品的质量以及提升生产效率，随着业务规模的逐步扩大，公司也在不断积极开拓新市场，扩展新产品，保持公司产品竞争优势，不断推动公司健康发展。感谢您的关心。 2、简要介绍一下公司 25 年上半年的各领域的研发进展情况 您好：电子陶瓷领域方面，公司将巩固现有通信器件用电子陶瓷外壳、汽车电子件产品领域，大力开发消费电子陶瓷外壳及基板、精密陶瓷零部件，搭建“材料+精益技术”发展体系。继续扩大光通信市场的优势，2025 年上半年，抓住光模块市场迅猛增长的市场机遇，加快电子陶瓷外壳生产线项目建设，快速扩产，氮化铝陶瓷基板产品实现大幅增长。针对半导体设备市场，全面开发陶瓷零部件产品，实现阶段性进展。针对消费电子市场的逐步回暖，重点开发声表、晶振类产品、氮化铝陶瓷基板产品，实现重点客户的批量交付。 第三代半导体氮化镓通信基站射频芯片与器件领域，紧密围绕战略目标，坚持“市场牵引、科技驱动”，在保持现有优势的基础上，进一步提升市场占有率，保障公司持续、健康、稳定发展。实施积极的扩张型市场战略，通过构建专业化营销体系、深化客户需求导向的产品开发、优化市场投放策略三位一体的方式，持续提升产品市场竞争力和占有率。持续加大研发投入，加快核心产品的研发。围绕 5G-A、6G、卫星通信及电力电子新能源等系统应用需求，开展新技术攻关，推动产业化应用，吸引高
--	--

	端人才，保持企业技术竞争力。 第三代半导体碳化硅功率模块及其应用领域,2025年上半年,碳化硅芯片晶圆工艺线经过升级改造由6英寸升级为8英寸,目前已通线,处于产品升级及客户导入阶段,今后将有效提升国联万众碳化硅功率产品的市场竞争力。感谢您的关心。 3、公司对自身的几块业务未来的预期大概是什么样的,有预估的发展步骤和阶段吗 您好,随着AI算力需求的持续增长,将推动数字经济蓬勃发展,带动半导体、通信、消费电子、新能源汽车等行业持续增长,以光模块为代表的电子元器件和半导体设备等行业市场规模持续稳步上升。在技术和工艺上,公司深耕第三代半导体与电子陶瓷两大领域:基于自有先进芯片技术,氮化镓通信基站射频器件领域持续保持国内市场占有率第一,碳化硅功率半导体覆盖多电压系列,获新能源汽车领域头部客户认可,并且正在攻关高压领域。在电子陶瓷领域,公司已研发的400GTbps、800Gbps、1.6Tbps等光通信器件外壳和基板已批量供货,公司建立了完善的精密陶瓷零部件制造工艺平台,其中陶瓷加热盘产品已量产稳定交付,满足国产半导体设备客户需求,精密陶瓷零部件产品通过上机验证,应用于半导体关键设备中。 公司与国内外领先企业建立长期合作,氮化镓通信基站射频器件产品支撑了我国5G移动通信网络的大规模基础设施建设,在国内细分领域市场占有率第一;碳化硅功率模块已供货新能源车头部客户,成为众多龙头企业核心供应商。电子陶瓷领域凭借优异的产品性能和可靠的产品质量,现已成为大批国内外通讯行业领先企业的核心供应商。感谢您的关心。 4、公司上半年净利润的增速远超营业收入的增长速度,是因为产品结构的变化吗?能具体说明一下增长幅度不同的原因吗 您好,2025年上半年净利润增速高于营业收入增速主要原因为公司高端产品放量,叠加降本增效效果明显,公司盈利能力
--	---

	显著提升。感谢您的关心。 5、公司募投项目建设进展情况如何？ 您好，公司目前募投项目共计 4 项，均为重组募投资金建设项目，公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金使用用途不发生变更的前提下，将部分募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 10 月。 “氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”根据项目的实施主体博威公司战略规划及实际发展需要，2024 年 8 月对本次募集资金投资项目“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”实施地点进行了变更。本次实施地点变更有利于募集资金投资项目实施和管理，优化项目布局，统筹规划项目建设，推进募集资金投资项目顺利实施，符合经营发展需要，目前处于开工建设阶段，项目主体封顶。 “第三代半导体工艺及封测平台建设项目”自项目建设以来，因受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化等客观因素影响，为确保投入有效性、适应外部环境变化，且不产生额外的资源浪费，公司依据中长期发展战略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进本项目的实施。 公司其他建设项目按照计划进行。公司本次调整募投项目实施进度是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的审慎决定，符合公司经营发展的需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。感谢您的关心。 6、请问目前公司陶瓷产品的下游各个应用场景的占比分别占多少？目前运用于光模块陶瓷产品的竞争格局是什么？ 您好！公司陶瓷产品包括：通信器件用电子陶瓷外壳、工业激光器用电子陶瓷外壳、消费电子陶瓷外壳及基板、汽车电子件、
--	---

	精密陶瓷零部件，广泛应用于光通信、无线通信、轨道交通、工业激光、消费电子、低碳供热制冷、汽车电子、半导体设备等领域。 光通信市场的繁荣给公司光通讯相关产品领域订单带来增长，公司氮化铝多层薄膜产品实现快速增长，产品应用于高频高速光模块中，应用于 AI 智能和数据中心等新场景。公司时刻关注该类产品更新换代趋势，紧跟市场及技术方向来加快新产品开发，产品结构将随市场需求变化而调整。公司在积极开展现有业务的同时，也在不断探索和跟进行业发展趋势及市场需求，感谢您的关心。 7、请问公司半年度报告中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长 55.06%的原因是什么？ 您好，扣非增长主要系受公司产品结构优化及成本管控增强，公司毛利水平有所增加。谢谢您的关心。 8、请问公司产品与珂玛科技的产品是否存在共通之处，是否与珂玛科技存在竞争关系，公司的竞争优势在哪里 您好！公司已开发了精密陶瓷零部件用氧化铝、氮化铝核心材料和配套的金属化体系，建立了完善的精密陶瓷零部件制造工艺平台，开发的陶瓷加热盘产品核心技术指标已达到国际同类产品水平并通过用户验证，实现了关键零部件的国产化，已批量应用于国产半导体关键设备中。2025 年上半年陶瓷零部件新产品研发实现阶段性进展，已通过国产半导体设备上机验证，并实现批量供货。谢谢您的关心。 9、梁总您好！请问博威公司在建厂房封顶了吗？什么时候能投产？ 您好！“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”根据项目的实施主体博威公司战略规划及实际发展需要，2024 年 8 月对本次募集资金投资项目“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”实施地点进行了变更。本次实施地点变更更有利于募集资金投资项目实
--	---

施和管理，优化项目布局，统筹规划项目建设，推进募集资金投资项目顺利实施，符合经营发展需要，目前处于开工建设阶段，项目主体封顶。感谢您的关心

10、公司和国基南方的国博电子是同控股方，是否存在同业竞争的问题？准备怎样解决这一问题？

您好，公司重组过程中实际控制人中国电科已作出承诺：为解决现有少量同业竞争，承诺在重组完成后 5 年内以合法方式解决。感谢您的关心。

11、请问贵公司的芯片半导体业务进展如何

您好，公司氮化镓通信基站射频芯片：分为大、小功率氮化镓通信基站射频芯片两种，覆盖芯片生产制造环节，主要为博威公司及国联万众提供其终端产品所需的氮化镓通信基站射频芯片。感谢您的关心。

12、电子陶瓷材料及元件的营业收入同比增长 18.6%，第三代半导体器件及模块同比增长 0.44%，电子陶瓷材料及元件收入增长与哪些影响因素有关？

您好，随着 AI 算力需求的持续增长，推动数字经济蓬勃发展，带动半导体、通信、消费电子、新能源汽车等行业持续增长，以光模块为代表的电子元器件和半导体设备等行业市场规模持续稳步上升。同时，公司加快电子陶瓷材料及元件新研发产品批量生产，从而使该业务板块收入增长。感谢您的关心。

13、董事长先生您好！请问贵公司的氮化镓技术在 AI 算力及人形机器人领域的应用有哪些？

您好！公司氮化镓通信基站射频芯片与器件：在通信基站中主要用于移动通信基站发射链路，实现对通信射频信号的功率放大，根据应用场景不同，氮化镓通信基站射频芯片与器件分为大功率基站氮化镓射频芯片及器件和 MIMO 基站氮化镓射频芯片及器件。微波点对点通信射频芯片与器件主要应用于点对点通信数据无线回传系统。围绕 5G-A、6G、卫星通信及电力电子新能源等系统应用需求，开展新技术攻关，推动产业化应用。感谢您的

关心！

14、请问贵公司跟英伟达有没有合作？

您好，中瓷电子是拥有氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及其应用、电子陶瓷等核心业务能力的高科技企业。出于商业保护和与客户协议的约定，公司不方便透露具体客户，敬请理解。感谢您的关心。

15、氮化铝薄厚膜产品主要应用于光模块什么功能？市场规模如何？

您好！氮化铝薄厚膜产品主要实现光芯片的散热和电信号传输功能，AI 算力需求的持续增长，推动光模块市场规模持续增长。感谢您的关心！

16、公司在建工程中的电子陶瓷外壳生产线项目预计什么时候能够开始投产？产能爬坡预计多久？这个产线设计的目的是做 3.2T 的光模块陶瓷还是什么别的产品？

您好，公司抓住光模块市场迅猛增长的市场机遇，加快电子陶瓷外壳生产线项目建设，快速扩产，产能将陆续释放，支撑氮化铝陶瓷基板、消费电子等陶瓷外壳产品实现快速增长。感谢您的关心。

17、公司市值管理方面有没有什么具体的举措？

您好，公司重视市值管理工作，公司以高质量发展为前提，稳步提升公司经营效率和盈利能力，夯实市值管理工作，多措并举，推动公司投资价值趋向合理。具体的举措主要包含以下几个方面：1、持续提高公司发展质量；2、积极开展有利于提高投资价值的产业链布局、延伸；3、持续完善公司治理体系。公司全面贯彻“两个一以贯之”，持续在完善公司治理中加强党的领导，充分发挥党建引领作用；4、全面提高公司信息披露质量，力争信息披露评级保持 A 级。不断提高 ESG 专业治理能力、风险管理能力，力争在资本市场发挥示范作用。5、主动加强投资者关系管理，建立多层次良性互动，推动业绩说明会常态化召开。6、稳定投资者回报预期。制定合理可持续的利润分配政策，增

	强现金分红稳定性、持续性和可预期性，适时增加分红频次，优化现金分红节奏。7、加强规范运作，严守合规底线。感谢您的关心。 18、你好截止今天股东人数多少呀 您好，根据中国登记结算深圳分公司提供的数据，截至 2025 年 8 月 29 日收盘，公司股东总户数 24,528 户（已合并）。感谢您的关心。 19、对于今天中瓷电子股票的大跌怎么看？ 您好，二级市场股价受行业、宏观经济环境、投资者价值判断及资本市场整体状况等多方面因素共同影响，请投资者谨慎判断，注意投资风险，感谢您的关心。 20、请问母公司报表变动幅度大的原因是什么？ 您好，主要是母公司数据统计口径变化，2025 年初向子公司国联万众无偿划转高新区分公司业务资产及负债，母公司报表期末/本期数据不再包含分公司。感谢您的关心。 21、你好！1. 请问公司光模块配件是否已具备 3.2T 的技术及生产能力，有客户试用没？2. 请问公司的氮化镓芯片是否已应用于华为的卫星通讯？且是否具备未来 6G 应用的可能？ 您好，中瓷电子光通信器件外壳传输速率已覆盖 2.5Gbps、10Gbps、25Gbps、100Gbps、200Gbps、400Gbps、800Gbps、1.6Tbps，并均已实现量产，中瓷公司正积极配合客户进行 3.2Tbps 产品的研发工作。公司氮化镓通信基站射频芯片，分为大、小功率氮化镓通信基站射频芯片两种，覆盖芯片生产制造环节，主要为子公司博威公司及国联万众提供其终端产品所需的氮化镓通信基站射频芯片。子公司博威公司正在积极推进 6G、星链通信等新一代通信系统用射频芯片与器件关键技术突破和研发工作，根据用户需求，稳步推进产品开发和验证工作，感谢您的关心。
附件清单(如有)	无
日期	2025-9-2